산업통상자원부

보 도 자 료

다시 도약하는 대한민국 함께 잘사는 국민의 나라

보도 일시	2023. 2. 23.(목) 11:00 < 2.24.(금) 조간 >	배포 일시	2023. 2. 23.(목)
담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장 이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관 라정인 (044-203-4276)

정부, 삼성전자 · 에스케이(SK)하이닉스와 함께 반도체 고급인력 2,365명 양성

- 민관공동투자 반도체 고급인력양성 투자(총 2,228억 원) 협약식 개최 -

- 기억장치, 시스템반도체, 소부장 115개 연구 개발 과제를 통한 인력양성 -

□ 산업통상자원부(장관 이창양)는 **반도체 석박사 고급인력양성**을 위한 '**민관공동투자 반도체 고급인력양성사업**(이하 민관공동 R&D사업)' 의 **민관공동투자 유치 체결식**을 2.23.(목) 서울 보코호텔에서 개최했다.

○ 이날 행사에는 산업계를 대표한 삼성전자, SK하이닉스가 참여하여 「**민관공동투자 반도체 고급인력양성사업 투자협력 양해각서**」를 체결하고 **총사업비 2228억 원**을 **정부와 함께 투자**하기로 하였다.

* 서명 : 산업부, 삼성전자, SK하이닉스, 한국반도체산업협회, 한국산업기술평가관리원

< 민관공동투자 유치 체결식 및 포럼 개요 >

◇ **일시/장소** : '23.2.23(목) 14:00~16:30, 서울 보코 호텔

◇ **참석** : 산업통상자원부, 삼성전자, SK하이닉스, 한국반도체산업협회, 한국산업기술평가관리원, 반도체 관련 산학연 전문가 100여 명

◇ **주요내용** : 민관공동투자 유치 체결식, 반도체 발전전략포럼

□ 산업부는 지난 7월 21일(목) 발표한 '**반도체 초강대국 달성전략**' 의 후속 조치로 **반도체 석박사 고급인력양성**을 위한 **민관공동 연구 개발(R&D)사업**을 산업계 및 전문기관과 함께 준비해 왔다.

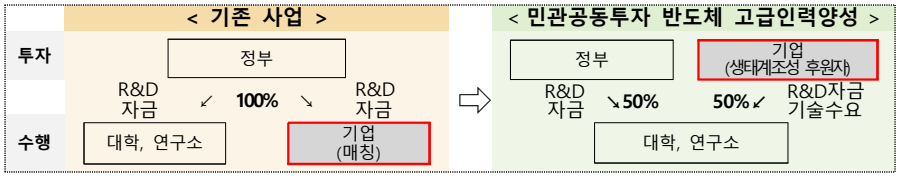
○ 민관공동 연구 개발(R&D)사업은 **석박사과정 인력**이 **산업계 수요 R&D과제**를 수행하여 **기업이 요구**하는 **전문역량**을 보유한 **고급인력**으로 양성되는 사업으로

○ **기업**이 직접 **발굴·제안한 연구 개발(R&D)과제**를 통해 기업은 **대학의 인력을 활용**하여 **핵심 원천기술**을 확보하고, **대학**은 기업의 연구 개발(R&D)과제 수행을 통해 **기업과의 기술 간극**을 **해소**하여 **실전경험**을 보유한 **전문인력**을 양성한다.

○ 이를 통해 **향후 10년간 2,365명 이상**의 **실전형 석박사 고급인력**을 배출할 수 있을 것으로 기대된다.

□ 반도체 업계와 산업부는 민관공동 연구 개발(R&D)사업을 위해 **반도체 인력 양성과 연구개발 생태계 조성**을 위한 **투자 참여 및 협력 지원** 등의 **업무협약(MOU)을 체결**하였다.

○ 정부와 업계는 **2023~2032년**까지 **총사업비 2,228억 원**을 50대50으로 투자하여 산업계가 필요한 **반도체 전체 분야의 핵심기술 확보** 및 **실전형 고급인력 양성**을 위해 전방위적으로 지원할 예정이다.



○ 또한, **업계는** 반도체 첨단기술 확보 및 우수인력 양성을 위한 **과제 발굴**부터 기업 엔지니어의 기술멘토링을 통한 **대학의 산학 연구 개발(R&D) 지원**까지 적극 협력하기로 약속하였다.

○ 이를 위해, **삼성전자와 SK하이닉스**는 올해 민관공동 연구 개발(R&D)과제기획 시 반도체 선단기술개발 및 애로기술 해소를 위한 **과제발굴**에 적극적으로 **참여**하였으며, 이를 통해 정부는 **'23년 R&D과제 47건**을 추진한다.

□ 민관공동투자 유치 체결식과 함께 개최된 '**반도체 발전전략 포럼**' 은 글로벌 반도체 경제 전망 분석, 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 기술 전망 발표 등을 통해 **산학연간의 반도체 정보교류** 및 **소통**의 장이 되었다.

□ 산업부 이용필 첨단산업정책관은 "**민관공동투자 유치 체결식**은 산업기술 패권의 핵심인 **반도체 산업의 기술경쟁력 확보** 및 **우수 인력양성**이라는 두 가지 숙제를 **민간과 정부가 원팀**으로 해결해가는 중요한 첫걸음으로,

○ 정부는 지속적으로 민간과 협력하여 **선순환적인 반도체 산업의 생태계 조성**를 위해 노력해 나가겠다” 라고 말했다.

【붙 임】 1. 민관공동투자 유치 체결식 및 반도체 발전 전략 포럼(안)
2. 반도체 발전전략 포럼 내용 요약



붙임 1 **민관공동투자 유치 체결식 및 반도체 발전 전략 포럼(안)**

□ 행사 개요

○ **(일시/장소)** 2023. 2. 23.(목) 14:00~16:30 / 보코 호텔(신사동)

○ **(내용)** 민관 공동 투자 유치 MOU 체결 및 반도체 발전전략 포럼

- **(MOU 내용)** 정부와 기업의 R&D 사업 투자 참여 및 협력 지원
- **(발전포럼)** 글로벌 반도체 전망, 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 기술 전망, 반도체 패키징 선도전략

○ **(참석대상)** 산업부, MOU 서명자*, 산학연 관계자 100여명 내외

* (산업부) 이용필 국장 / (업계) 송재혁 CTO(삼성전자), 차선용 원장(SK하이닉스) / (전담기관) 전윤종 원장(한국산업기술평가관리원) / (협회) 이창한 부회장(반도체협회)

□ 세부 일정

시 간	내 용	비고
14:00~14:10 (’10)	모두발언	산업부, 산기평
14:10~14:20 (’10)	민관공동투자 반도체 고급인력양성사업 소개 및 추진 경과	산기평
14:20~14:30 (’10)	투자유치 체결식 서명 및 사진 촬영	산업부, 산기평, 협회, 투자기업
14:30~14:40 (’10)	장내 정리	
14:40~15:00 (’20)	글로벌 반도체 전망 및 투자 전략	유진투자
15:00~15:30 (’30)	한계돌파를 위한 반도체 로직 디바이스 기술	삼성전자
15:30~16:00 (’30)	차세대 메모리 반도체 기술전망	SK하이닉스
16:00~16:30 (’30)	반도체 초격차 경쟁력을 위한 패키지 선도전략	차세대지능형반도체사업단
16:30 ~	폐 회	

붙임 2 **반도체 발전전략 포럼 내용 요약**

□ 유진투자증권

< 2023년 글로벌 반도체 전망 및 투자 전략 >
ㅇ 2022년 반도체섹터 리뷰를 통하여 코로나 팬더믹 이전과 이후의 반도체 산업 및 시장의 평가 분석 ㅇ 한국 반도체 산업과 글로벌 수요 시장의 현황을 살펴보며 투자 관점의 주안점 모색

□ 삼성전자

< Logic Device Technology & Future Preparation >
ㅇ 반도체 한계를 정면 돌파하기 위한 로직 디바이스 기술에 대한 기술 개발 현황 파악 ㅇ 미래 산업에서 반도체 기술의 역할과 중요성에 대해 강조하며, 지금 확보해야할 산업적 / 기술적 관점의 준비사항 제안

□ SK하이닉스

< 차세대 메모리 반도체 기술전망 >
ㅇ IT, AI 등 반도체 수요 시장의 변화에 따라 반도체에 요구하는 기술적 요건을 살펴보며 반도체 기업과 산업에게 시사점 도출 ㅇ DRAM, NAND, 이머징 메모리 등 현 기술의 한계를 극복하고 반도체 수요 시장의 요구조건에 부합하기 위한 차세대 메모리 기술 발전 방향 조망

□ 차세대지능형반도체사업단

< 반도체 초격차 경쟁력을 위한 패키지 선도전략 >
ㅇ 향후 반도체 시장의 요구에 따라 반도체 패키징 기술의 중요성 강조와 확대되는 시장의 수요 예측 ㅇ 초격차 반도체 Post-Fab을 위한 비전과 전략 제시